

속보 자료

투자자 관련 담당:

Ed Lockwood

전무 이사, 투자자 관계

1-(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

언론 관련 담당:

Meggan Powers

전무 이사, 기업 커뮤니케이션

1-(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor, 인쇄/에칭 공정 제어 포트폴리오에 추가될 신제품 2 종 발표

20nm 이하급 메모리 및 마이크로프로세서 칩 제조 공정의

첨단 패터닝 기법을 지원하는 새로운 계측 및 검사 장비

캘리포니아주 밀피타스 2013. 2. 25.—[KLA-Tencor Corporation](http://www.kla-tencor.com)(NASDAQ: KLAC)은 SPIE Advanced Lithography 컨퍼런스에서 SpectraShape™ 9000 CD(옵틱 임계 치수) 계측 시스템과 BDR300™ 후면 불량 검사 및 검토 모듈을 공개했다. SpectraShape 9000은 3차원 트랜지스터, 기억 소자 등 고성능 메모리 칩과 마이크로프로세서 칩의 제작을 가능하게 하는 핵심 구조의 형태를 모니터링할 수 있는 새로운 계측 시스템이다. BDR300은 웨이퍼 후면을 검사하고 검토하여 웨이퍼 전면에서 패터닝 문제를 일으킬 수 있는 불량을 찾아낸다. 새롭게 선보이는 이 두 시스템은 20nm 이하급 설계 규칙을 적용한 통합 회로의 대량 생산을 지원하도록 설계되었다.

"193nm 담금 리소그래피 기술의 사용 범위가 대폭 확대된 최근의 업계 환경에서 고객들은 극도로 엄격해진 리소그래피와 에칭의 공정 허용 오차 문제를 해결하기 위해 몇몇 분야에서 혁신을 시도하고 있다"고 말하는 KLA-Tencor 최고 마케팅 책임자 Brian Trafas 박사는 "오늘 출시한 두 제품은 이 분야에서 두 가지 중요한 공정 제어 문제, 즉 형태의 작은 편차로 인해 발생하는 스캐너 초점 관련 불량과 finFETs, 수직 적층된 NAND 등 3차원 구조의 오류나 성능 저하 문제를 해결해 준다. BDR300과 SpectraShape 9000은 리소그래피와 에칭 분야에서 고객이 현재 직면한 중대한 당면 과제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있도록 설계되었다"고 밝혔다.

새로운 SpectraShape 9000에는 레이저 작동식 플라즈마 광원을 비롯하여 다양한 소재와 구조에 대해 첨단 치수 계측 기능을 지원하는 여러 가지 발전된 기술이 채용되었다. 20nm 이하급 노드에서 보다 엄격한 제어 능력을 필요로 하는 업계의 요구를 반영하여 SpectraShape 9000은 종전 제품보다 감도와 처리 성능을 높였다. 레이어 수가 갈수록 늘어나는 상황에서 웨이퍼 하나당 더 많은 부분을 측정해야 하는 문제를 해결할 수 있게 된 것이다. 또한 혁신적인 대량 생산 리소그래피 공정을 위한 혁신적인 계측 목표를 지원한다.

새로운 CIRCL™ 클러스터 설비용 BDR300 후면 검사 및 검토 모듈은 종전 제품보다 불량 감도가 대폭 향상되어 반도체 공장에서 마이크론 단위 이하의 후면 불량을 찾아 분류할 수 있게 되었다. 이러한 불량이 많아질 경우 고급 노드에서 산출량이 저하될 수 있다. 이제 CIRCL 클러스터는 독립형 후면 검사 및 검토 시스템으로도 구매가 가능하다. 이 구성은 스캐너에

진입하기 전에 웨이퍼 후면을 검사해야 한다는 까다로운 업계의 요구 사항을 지원하기 위해 설계되었다. 웨이퍼 후면이 깨끗하면 스캐너척이 오염되고 후속 제품에 영향을 줄 가능성이 낮아진다.

이미 여러 대의 SpectraShape 9000 형태 계측 시스템이 유수의 논리 소자 및 메모리 칩 (선두) 제조업체에 설치되어 기존 CD/형태 계측 도구를 대체하면서 첨단 기술 개발을 가능하게 하고 추가 계측 능력에 대한 요구 사항을 한 차원 높이거나 충족하고 있다. BDR300 모듈이 포함된 첫 CIRCL 장비도 설치되어 기존의 사후 불량 검사 공정은 물론, 선제적 스캐너 모니터링에도 이용되고 있다. 첨단 생산 환경의 높은 성능 및 생산성 요구 사항을 지속적으로 지원하기 위해 [KLA-Tencor 는 포괄적인 글로벌 서비스망](#)을 통해 SpectraShape 및 CIRCL 장비를 지원한다.

SpectraShape 9000 시스템에 대한 자세한 정보는 [SpectraShape 제품 웹 페이지](#)에서 확인할 수 있다. BDR300 모듈 또는 CIRCL 시스템에 대한 자세한 정보는 [CIRCL 제품 웹 페이지](#)에서 제공된다.

KLA-Tencor 소개:

KLA-Tencor Corporation 은 공정 관리 및 수율 관리 솔루션 공급업체의 선두 기업으로서, 전 세계 고객들과 협력하여 최첨단 검사 및 측정 기술을 개발하고 있다. 이러한 기술은 반도체, LED 및 기타 관련 나노 전자부품 산업에 사용된다. 업계 표준 제품의 포트폴리오와 세계적인 수준의 엔지니어/연구 팀을 보유하고 있는 KLA-Tencor 는 35 년 이상 고객을 위한 우수한 솔루션을 만들고 있다. 미국 캘리포니아주 밀피타스에 본사가 있는 KLA-Tencor 는 전 세계적으로 고객 영업 및 서비스 전담 센터를 운영하고 있다. 보다 자세한 정보는 www.kla-tencor.com(KLAC-P)에서 참조할 수 있다.

전망 기술:

이 언론 보도 자료에서 발표된 SpectraShape 9000, CIRCL 또는 BDR300 의 기대 성능, 반도체 산업의 추세 및 그와 관련하여 예상되는 과제, KLA-Tencor 고객의 예상되는 SpectraShape 9000, CIRCL 또는 BDR300 사용 방식, SpectraShape 9000, CIRCL 또는 BDR300 과 기타 KLA-Tencor 도구 간의 호환성에 대한 예상, SpectraShape 9000, CIRCL 또는 BDR300 도구 사용자에게 예상되는 비용 및 운영상/기타 이점 등의 내용은 미래를 전망하는 내용으로, 1995 년의 Private Securities Litigation Reform Act(증권민사소송개혁법)에 따라 제정된 Safe Harbor(면책 규정) 조항의 적용을 받는다. 이러한 전망에 대한 내용은 현재 정보와 예측을 근거로 이루어졌으며 많은 위험성과 불확실성이 수반된다. 신기술 채택의 지연(비용 또는 성능 문제 또는 다른 이유로 인해), 다른 회사에서 제공하는 경쟁제품의 도입, KLA-Tencor 제품의 구현, 성능 또는 사용에 영향을 주는 예상치 못한 기술적 어려움이나 한계 등 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 해당 내용에서 예측된 것과 크게 다를 수 있다.

###